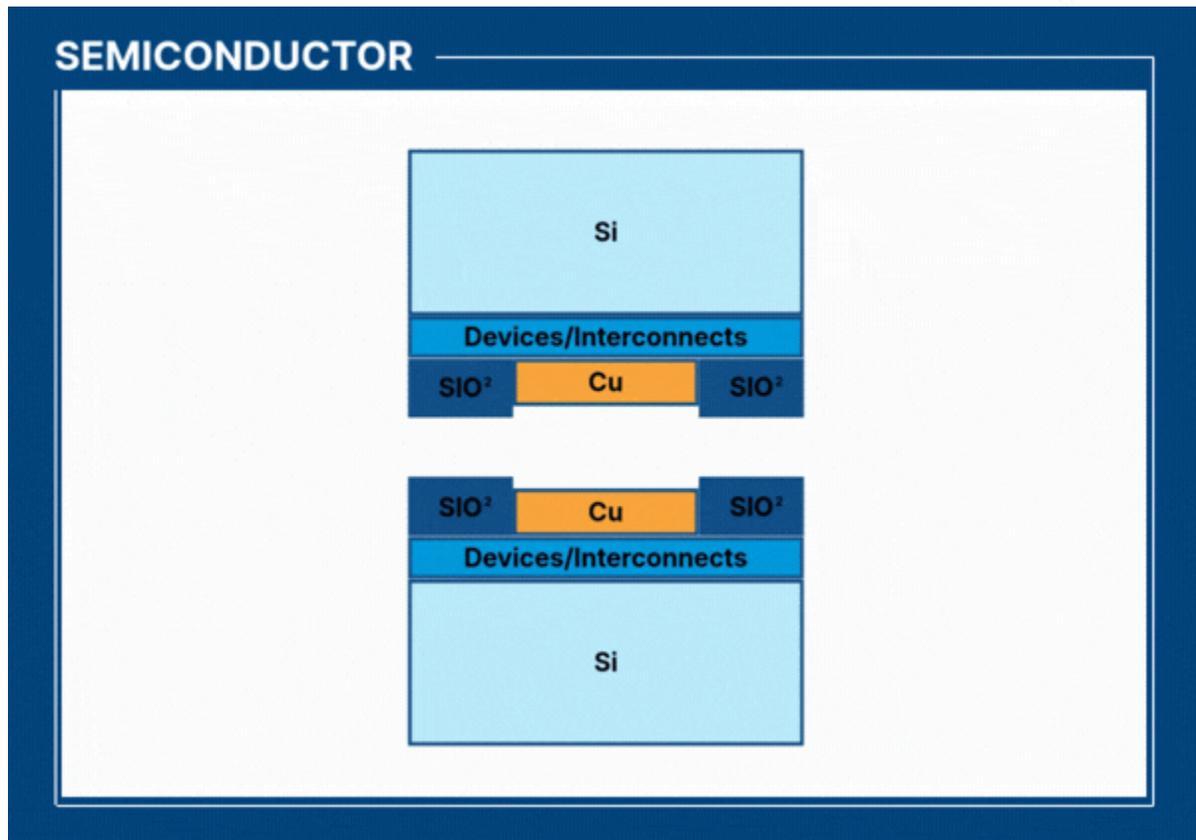


Baslerより新着情報をお届けします。



100nm級のアライメントへ

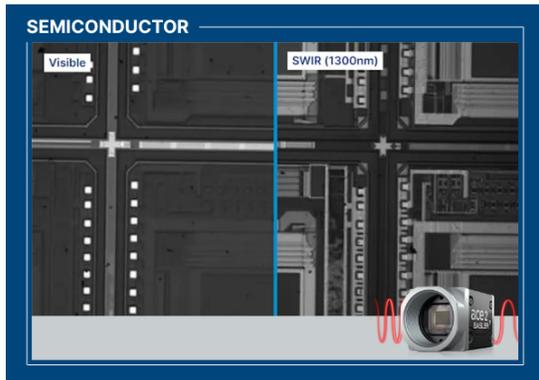
～高精度ハイブリッドボンディング検査の実現に向けて

配線間隔が100 nm未満へと微細化するなか、位置ズレの許容範囲も100 nm級まで厳しくなっています。熱による位置変動やウエハーの反り、光学条件の変動は直接的な影響を及ぼし、シリコンや誘電体層下に埋め込まれたアライメントマークは従来のイメージングでは確認が困難になります。

ハイブリッドボンディング検査には、光学設計の再構築や高精度で安定した測定技術が不可欠です。Baslerは「見えない＝管理できない」の考えのもと、次世代技術の精度限界と実現性を評価しています。

[高精度アライメントの詳細・ご相談はこちら](#)

半導体検査 注目トピックのご紹介



SWIRで実現する シリコン内部の アライメント可視化

アライメントマークがシリコン内部に配置される工程では、可視光では十分な観察ができない場合があります。SWIRイメージングはシリコンを透過し、Die-to-WaferやWafer-to-Waferボンディングに必要なコントラストと安定した位置合わせを可能にします。

[SWIRアライメントの詳細を見る >](#)



アドバンスド パッケージングを 支える検査・計測技術

3Dスタッキングや先進HBMアーキテクチャなど、異種集積の進展に伴いプロセスはますます複雑化しています。

その中で、検査や計測は単なる補助工程ではなく、プロセスの安定化とスケラブルな量産を支える重要な役割を担っています。

[検査ソリューションを見る >](#)

Baslerニュースレターのご案内

最新の技術動向、Baslerの製品・サービスに関する最新情報や

半導体外観検査に役立つ情報をお届けしています。

ご登録がお済みでない方は、この機会にぜひご登録ください。

[登録する\(ワンクリックで登録\)](#)

baslerweb.com